

Title (en)

Blade ring-type chip shredder for cutting coarse chips

Title (de)

Messerring-Zerspaner zum Zerspanen von Hackschnitzeln

Title (fr)

Déchiqueteuse à lames-couronne pour couper des copeaux

Publication

EP 1050390 A2 20001108 (DE)

Application

EP 00108300 A 20000414

Priority

DE 19921597 A 19990507

Abstract (en)

[origin: US6561885B1] A ring cutter that cuts chips with a ring of knives. Two carrier rings enclose a collar of knife packets. Each knife packet includes a knife clamped between a knife carrier a clamping plate with a cutting edge of the knife pointing to the inside of the ring. Fastening screws are threaded through a borehole in the clamping plate and an opening in the knife and are screwed into a threaded borehole in the knife carrier. One of the fastening screws is configured as an alignment pin.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Messerring-Zerspaner zum Zerspanen von Hackschnitzeln; mit einem Messerring (1), umfassend einen Kranz von Messerpaketen sowie zwei diese tragende Tragringe (5.1,5.2), die die Messerpakete zwischen sich einschließen; mit einem Rotor (2), der eine Vielzahl von Rotorscheufeln (2.1) trägt; jedes Messerpaket enthält die folgenden Teile: einen Messerträger (1.2), eine Klemmplatte (1.3), ein zwischen Messerträger und Klemmplatte eingespanntes Messer, dessen Schneide nach innen weist; wenigstens zwei Befestigungsschrauben (4), die jeweils durch eine Bohrung (1.3.1) in der Klemmplatte (1.3) und durch eine Öffnung im Messer hindurchgeführt und in eine Gewindebohrung (1.2.2) im Messerträger (1.2) eingeschraubt sind; wenigstens eine der Befestigungsschrauben (4) ist auf einem Teil ihrer Länge als Paßstift (4.3) ausgebildet; die zugehörigen Bohrungen von Klemmplatte (1.3) und Messerträger (1.2) sind wenigstens auf einem Teil ihrer Länge als Paßbohrungen ausgebildet und dort auf den Durchmesser des Paßstiftes (4.3) abgestimmt. <IMAGE>

IPC 1-7

B27L 11/00

IPC 8 full level

B02C 18/18 (2006.01); **B02C 18/14** (2006.01); **B27L 11/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B27L 11/005 (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

US 6561885 B1 20030513; AT E336346 T1 20060915; BR 0002084 A 20010102; DE 19921597 C1 20000727; DE 50013318 D1 20060928; DK 1050390 T3 20061227; EP 1050390 A2 20001108; EP 1050390 A3 20040428; EP 1050390 B1 20060816; ES 2269036 T3 20070401; JP 2000350940 A 20001219

DOCDB simple family (application)

US 56186400 A 20000428; AT 00108300 T 20000414; BR 0002084 A 20000508; DE 19921597 A 19990507; DE 50013318 T 20000414; DK 00108300 T 20000414; EP 00108300 A 20000414; ES 00108300 T 20000414; JP 2000133966 A 20000502